

# 自动晶圆切割清后清洗机

产品名称	自动晶圆切割清后清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

全自动晶圆切割清后清洗机一种高频清洗机，在清洗中发挥着强大的作用。

可用于去除半导体晶圆、液晶和硬盘等超细颗粒。

高频（750kHz、950kHz）的超音速清洗主要以加速度进行清洗。因此，气穴很少发生。

它对于解决气穴引起的情色（损坏）和驻波引起的清洁不均匀性非常有用。

全自动晶圆切割后清洗机特点：

0.1W 功率可配置。实现高功率稳定性。易于\*\*\*的输出控制，支持无损坏的清洁！（支持 200kHz 或更高）

四种特殊振荡模式选择可实现比以往更高的清洗。

启动和下降的速度。

全自动晶圆切割后清洗机与高兆声波系列兼容，可通过更换振荡器提高清洁性能。

与以前的 Homega 78101 型号相比，它缩小到 81%，重量减轻至 17 kg！

尺寸标准化，可放入 19 英寸机架中。

更换振子时无需调整（无匹配）。

全自动晶圆切割后清洗机由于功率是自由电源系统，因此不受工厂电源电压波动的影响

外观简洁大方,整机采用PLC系统控制，易于操作，；

功能：通过喷洒出微小且高压力的纯净水将切割后的晶圆清洗干净。

全自动晶圆切割后清洗机通过更改参数自适应12英寸以下的晶圆；

通过更换台盘能适应标准6”和8”和12”框架（Frame）；

出水压力可调，范围：2.0~11.8MPa（20~120 kgf/cm<sup>2</sup>）；

全自动晶圆切割后清洗机电机采用AC变频电机，摆臂电机采用伺服电机。

可分开调节喷水和喷气时主轴旋转速度，范围：0~3000 rpm；

采用彩色触摸屏作为人机操作界面；

全自动晶圆切割后清洗机喷头喷洒范围可自动根据设定的晶圆大小调节，无需人工干预；

具有气体压力和出水压力调节功能；

具有氮气输入接口；

具有“紧急停止”功能；

全自动晶圆切割后清洗机具有系统运行状态监控和设备故障报警功能；

适应晶圆尺寸：12寸以下

电器部分采用国外\*\*\*产品，系统可靠；